

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2024 年 5 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	5 月 9 日 10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:30-13:30, 14:00-15:00, 15:00-16:00 中邮证券、西南证券、国海证券、美银证券、国新证券、长江证券、首创证券、中欧基金、汇添富基金、长城基金、银华基金、睿远基金、彬元资本、蜂投资管、国都资管、泮谊投资、兴业基金、北京京管泰富基金、四川璞信产融投资、亚太财险、新华基金、银杏资本、合煦智远基金、北京衍航投资、招商基金、九泰基金、光大永明人寿、宏利基金、兴合基金、中银国际证券、盈峰资本、仁桥资产、华龙证券、建信信托、淡水泉投资、长盛基金、泓德基金、光大永明资产、大家资产、华安财保资产、长城财富保险资产、嘉实基金、英大基金、Hel Ved Capital Management、TT International Asset Management、Value Partners、Van Eck Associates Corporation、Yiheng Capital、Balyasny Asset Management、Construction And Building Union、FengHe Fund Management、Pictet Asset Management、Pinpoint Asset Management、Point72

	Capital Management 5月10日 09:30-10:30 , 11:00-12:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00 华鑫证券、交银电子、长信基金、磐厚动量资本、恒越基金、启泰基金、中信保诚、长江养老、光大证券、中信证券、新华资产、阳光资产、Millennium、Ballie Gifford、华宝基金、东北证券自营、淳厚基金、太平资管、西南证券自营、朱雀基金、中海基金、野村东方、泓德基金、高毅资产、千禧年投资、Point72 Capital Management、淡水泉投资、天弘基金、弥远投资、中信建投证券、东方证券、人保资产、瑞银证券、泰康基金 5月22日 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00 Fidelity Management、T. Rowe Price、Allianz Global、Antipodes Partners、Artisan Partners、Goldman Sachs Asset、Kontiki Capital、Putnam Investments、UBS Asset、ION Analytics、北京博润银泰投资、北京沃衍资本、上海星广丰投资、上海至顺投资、深圳安卓投资、鸿运私募、闻天私募、粤开证券、北京世邦私募、中汇人寿、原点资产
时间	5月9日 10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:30-13:30, 14:00-15:00, 15:00-16:00 5月10日 09:30-10:30 , 11:00-12:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00 5月22日 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00
地点	无锡、上海

上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室副主任
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司判断行业周期是否出现触底复苏？ 答：消费电子领域一季度率先恢复，在订单方面有明显增加。目前产业趋势已趋于稳定，处于温和复苏阶段。 问题二：请问公司如何展望下半年的终端景气度？ 答：随着下游库存出清、需求复苏，以及政策红利的推动，预测下半年行业景气度会上行，公司认为消费电子、汽车电子、新能源领域仍将发挥重要作用。 问题三：请问公司产品价格是否触底？ 答：目前可以看到下游库存去化进度已基本完成，公司订单呈现逐月增长，我们认为价格方面基本触底，年内有望逐步修复。 问题四：请问公司 IGBT 模块在汽车主驱方面的进展？ 答：公司在新能源汽车领域推出 750V/1200V 450A 以上多款 IGBT 主驱模块等，市场验证与客户拓展顺利进行。 问题五：请问碳化硅产品是否出现成本改善？ 答：目前碳化硅材料价格已出现明显下降；未来也将通过芯片面积减少、良率提升、平面转沟槽等方式持续改善成本。 问题六：请问公司晶圆制造产能利用率是否有改善？ 答：公司 6 吋及 8 吋产能利用率达到 90%以上，其中部分产品线已在 95%以上；12 吋处于爬坡上量以及客户验证阶段。

	问题七：请问公司是否有 AI 类相关产品？ 答：公司有 SGT MOSFET 等功率半导体产品可应用于 AI 服务器等领域，目前已有供货。 问题八：请问公司 2024 年资本性开支？ 答：公司 2024 年度投资预算为 86.1 亿元，股权投资占比 50%，固定资产投资占比 50%。公司投资规模将结合市场实际，在项目实施前进行内部审慎研判。 问题九：请问公司的竞争优势？ 答：公司聚焦于功率半导体、数模混合、智能传感器与智能控制领域，产品系列丰富，中高端产品比重不断增加。公司将不断发挥 IDM 商业模式的优势及产品组合的完整性，紧抓市场机遇，不断提高公司产品在细分领域的市占率。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月